Scheda tecnica prodotto

Articolo: TP150-H15-RPI-143

Famiglia/Categoria: THERMAL PAD - Silicon Foil

Materiale: Silicone

Descrizione

Interfaccia termica SILICON FOIL TP150-H15-RPI-143 in : dissipatore di calore ad alta conducibilità per moduli LED ed elettronica.

Applicazioni tipiche

Interfaccia termica ad alte prestazioni per la dissipazione del calore in sistemi elettronici di potenza. Progettata per massimizzare la conducibilità tra moduli LED/CPU e dissipatori in , il modello TP150-H15-RPI-143 previene il surriscaldamento del sistema.

Dati riassuntivi

Articolo:	TP150-H15-RPI-143
Famiglia:	THERMAL PAD
Categoria:	Silicon Foil
Materiale:	Silicone